

# L17-阻劑塗佈及顯影系統 ACT8 (TRACK ACT8)

## 考核項目清單 checklist

2018/02/01

### 1. 機台狀況檢查與一般異常處理

- 機台狀態檢查：狀態告示牌、設備使用記錄表。
- 一般警示訊號處理。
- 不可自行排除之警示訊號處理方式：通知負責工程師。

### 2. 設備危害認知及危機處理

- 設備危害認知。
- EMO 位置及使用時機。
- 緊急狀況處理：逃生動線與緊急連絡電話(值班室 7762)。

### 3. Chemical Box 與化學品的認識

- 單元名稱/內容物：chemical box、resist、developer、solvent、HMDS、drain tank。
- 安全資料表 (SDS) 的意義及放置位置。
- 沖身洗眼器位置及使用方式。
- 狀態判斷：normal、abnormal。
- 顯影液主名稱及危害：2.38%TMAH，見 AD-10 SDS。

### 4. 晶圓操作與晶舟取放

- 晶片拾取操作。
- 晶片檢查：破損、斜插、疊片、正反面錯置、晶片污染、薄膜剝落。
- 晶舟放置檢查。
- carrier stage 介面說明與操作。

### 5. 製程參數檢查、設定與機台操作

- 刷卡開機後首要檢查項目：ALARM。
- 製程參數檢查：製程模組狀態、晶片狀態。
- 溫度轉換方式及目的。
- 製程條件設定與 RUN 貨。
- 機台使用完畢後續 Transfer 動作。

### 6. 設備簡介與製程觀念說明

- 製程單元位置及功用：carrier station (carrier stage、cassette、wafer sensor、CS Arm、control panel、EMO)、main station (TRS、TCP、ADH、LHP、PHP、HHP、CPL、COT、DEV、PS Arm)。
- 製程流程及目的說明：ADH-CPL-COT-LHP、PHP-CPL-DEV-HHP。

### 7. 逾 30 分鐘未完成考試扣 25 分